

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div>√ 特定对象调研</div> <div>□ 分析师会议</div> <div>□ 媒体采访</div> <div>□ 业绩说明会</div> <div>□ 新闻发布会</div> <div>□ 路演活动</div> <div>□ 现场参观</div> <div>□ 电话会议</div> <div>□ 其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	南方基金、国寿安保基金、宝盈基金、瀚亚投资、红土创新基金、重阳战略、千合资本等
会议时间	2025 年 1 月 16 日 10：00-11：00
会议地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请介绍公司所处行业及产品的市场情况？</p> <p>回复：半导体封装材料是半导体产业的基石，根据 SIMIT 战略研究室公布的报告，90%以上的半导体芯片封装材料均采用环氧塑封料，因此，环氧塑封料已成为半导体产业发展的关键支撑产业。环氧塑封料是半导体产业中关键性的基础材料，半导体可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、5G 信息通讯、工业应用、物联网等各大领域，随着半导体在上述新兴领域市场需求逐步扩大，环氧塑封料市场增长空间较大。同时，随着国际贸易与全球地缘政治的关系持续变化，许多国家和地区都开始不同程度的加强半导体本土化发展策略，强化对半导体产业的投资和控制。高性能尤其是先进封装环氧塑封料目前主要由外资厂商垄断，依赖进口，长期属于“卡脖子”产品，国产替代空间大。</p>

	<p>我国半导体产业的总体发展水平与美欧日韩等世界先进国家和地区相比仍有较大差距，且在关键领域和环节存在突出的“卡脖子”问题，在此背景下，国内半导体供应链安全需求迫切。半导体产业链中，半导体材料位于上游环节，为半导体制造工艺的核心基础。目前，我国半导体封装材料国产化率较低，先进封装材料国产化率更低，基本被外资企业垄断，进口替代空间广阔。</p> <p>问题二：请问公司未来的研发方向？</p> <p>回复：公司将继续推动颗粒状塑封料（GMC）、底部填充塑封料（MUF）以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发进度，打破该领域“卡脖子”局面，打造世界级半导体封装材料企业。</p> <p>问题三：请问公司目前募投项目的运行情况？</p> <p>回复：公司募集资金项目进展顺利，相关项目主体建设已经初步完成，新的生产线将在投料、运输、称量、包装、码垛等全方面提升自动化水平，降低人力成本的同时实现更精准的产品质量管控，进而提升了运行效率，优化了产线配置。</p> <p>问题四：请问公司收购衡所华威有何战略意义？</p> <p>回复：公司和衡所华威均从事半导体芯片封装材料的研发、生产和销售，主要产品均为环氧塑封料，是半导体封装的关键材料。双方在以下多方面均有协同效应，具体如下：</p> <p>（1）加速国际化布局，扩大海外优质市场份额</p> <p>公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，目标客户一致。衡所华威及其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，品牌知名度高，积累了一批全球知名的半导体客户。优质客户对环氧塑封料供应商的筛选和考核标准严格，合格供应商认证周期较长，认证程序复杂。本次收购完成后，公司将借助衡所华威加速国际化布局，扩大海外优质市场份额。</p> <p>（2）补强产品矩阵，提升客户服务能力</p> <p>基于下游封装技术、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、高性能、先进封装等三类。在当下的行业格局中，高</p>
--	---

	<p>性能占据主流地位，而先进封装是未来的行业发展方向。本次收购完成后，公司借助衡所华威在先进封装方面所积累的研发优势，迅速推动先进封装材料的研发及量产进度，打破该领域“卡脖子”局面，逐步实现国产替代，打造世界级半导体封装材料企业。</p> <p>（3）供应链整合，优化采购成本</p> <p>公司与衡所华威主要产品原材料具有高度的重合性。本次并购整合完成后，双方集中采购规模上升，优化供应链管理能力，在采购端将获得更高的议价能力及资源支持。衡所华威长期积累的满足海外客户要求的供应链，将为公司产品和市场全球化拓展提供强有力的补充和支持，提高公司国际竞争力。</p> <p>（4）优化产线布局，提高生产效率</p> <p>环氧塑封料属于配方型产品，根据客户的定制化需求，产品型号较多。本次交易完成后，公司的产线分工将得到优化，提高产线的利用效率和生产效率，降低因频繁更换产品型号而导致的停机时间，同时减少原材料损耗，提高盈利水平。</p> <p>（5）整合研发资源，提高高性能和先进封装环氧塑封料研发投入</p> <p>双方同属于环氧塑封料行业，在产品配方、产品研发上具有较强的互补性和协同效应。本次交易完成后，双方研发充分整合，优势互补，提高研发速度，提升现有成果水平，同时避免重复研发，将节省的研发资源全力投入到高性能和先进封装环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，打破国外技术垄断。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 1 月 16 日